

Planamelt HSP II

Weichmacherfreier Schmelzklebstoff

Typische Anwendungen

- Klebebinden von Büchern, Katalogen, Broschüren, Telefonbüchern, Zeitschriften auf allen gängigen Klebebindeautomaten
- Ableimen von fadengehefteten Broschüren
- Two-shot-Verfahren – Vorleim (Primer) und Hauptleim mit unterschiedlichen Temperaturen

Weichmacherfreier Rückenleim mit mittlerer Klammerwirkung und ausgezeichneter Klebkraft. Die neue Polymerbasis von **Planamelt HSP II** verleiht diesem Klebstoff gegenüber einem Standard-EVA-Rückenleim folgende Vorteile:

- bessere Klebkraft
- bessere Oxidationsstabilität, dadurch erheblich weniger Reinigungsaufwand, schonend für Anlagen
- gute Öl-Beständigkeit
- deutlich bessere Blattkantenhaftung und Haltbarkeit der fertigen Produkte
- deutlich geringere Geruchsabgabe
- höhere Wärmestandfestigkeit und Kältestandfestigkeit
- deutlich niedrigerer Klebstoffverbrauch, ca. 20 – 60% durch den niedrigeren Klebstoffauftrag, abhängig von Substraten und Maschineneinstellungen.

Technische Daten

Spezifikationswerte

Viskosität * (Brookfield, DIN 53019, 170° C)	4.000 – 6.000 mPas
Erweichungspunkt (Mettler) *zum Zeitpunkt der Produktion	125 – 145° C

Typische technische Eigenschaften

Offene Zeit	mittel - kurz
Abbindezeit	mittel - kurz
Farbe	farblos bis leicht gelblich

Lieferform/Gebinde

Granulat, 25 kg Säcke, weitere auf Nachfrage

Allgemeine Anwendungshinweise

Verarbeitung

Arbeitstemperatur (gemessen auf der Walze):

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Ableimen | 140 – 170° C |
| - Rückenleim One shot: | 160 – 180° C |
| - Rückenleim Two shot Vorleim: | 170 – 180° C |
| - Rückenleim Two shot Hauptleim: | 150 – 160° C |
| - auf dem Spinnerrad/Rakel | ca. 10 - 15° C höher einstellen |
| - im Vorschmelzbehälter: | ca. 20° C niedriger, mindestens 150° C |

Bitte beachten Sie, dass mit der Veränderung der Arbeitstemperatur auch die anderen Parameter des Klebstoffes, wie offene Zeit, Viskosität und Klebkraft, sich verändern.

Längeres Heizen und mehrfaches Wiederaufheizen bewirken allmähliches Vergilben des Klebstoffes, zu langes und zu hohes Heizen führen zu dessen Unbrauchbarwerden, deshalb die aufgeschmolzene Klebstoffmenge dem Tagesverbrauch anpassen.

Vorschläge für Maschineneinstellungen

Rückenbearbeitung:

- Kerbtiefe: 0,5 - 1,2 mm
- Abstand der Kerben: 2,0 - 6,0 mm
- gleichmäßiger Klebstoffauftrag in der Stärke: 0,3 - 0,7 mm
- staubfreier Buchrücken
- **Anpressdruck des Umschlags auf den Buchblock muss im Vergleich zu EVA Klebstoff erhöht werden!**

Die Rückenbearbeitung und die Klebstoffauftragsmenge sind entsprechend der Papiersorte einzustellen. Grundsätzlich sollten die Papierfasern so gut wie möglich freigelegt werden. Bei leichten Papieren mit langen Fasern genügt eine schwächere Kerbung. Bei dünnen Papieren wie z.B. Tiefdruckpapier, oder sehr schweren gestrichenen Glanzpapieren muss auf die gute Rückenbearbeitung geachtet werden. Falls die Fräse mit Mikrokerbung oder fibre rougher vorhanden ist, sollte diese in 0,2-0,5 mm Tiefe zu einer normalen Kerbung geschaltet werden, um noch bessere Haltbarkeit der Klebebindung zu erreichen. Auch der Klebstoffauftrag kann nach Papierqualität optimiert werden: bei faserreichen leichten Papieren (z.B. Werkdruckpapier) reichen auch 0,2-0,3 mm Klebstoff aus. Bei schweren Papieren und dicken Bücher sollte 0,4-0,7mm auftragen werden.

WICHTIG! Planamelt ist eine neue Technologie, die nicht mit herkömmlichen Hotmelts vergleichbar ist. Es können nur dann hervorragende Ergebnisse erzielt werden, wenn die Anlage vorher gründlich gereinigt worden ist (siehe Reinigungsvorschlag im Beiblatt). Ferner empfehlen wir bei Ersteininsatz von Planamelt sich durch unseren Außendienst und unsere Anwendungstechnik beraten zu lassen, wie Sie durch optimale Maschinen- und Rückenbearbeitungseinstellungen wesentlich bessere Resultate als bei herkömmlichen Hotmelts erzielen können.

Lagerung

Empfohlener Verarbeitungszeitraum: siehe Etikett

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet im Originalgebinde, kühl und trocken gelagert. Empfohlene, optimale Lagertemperatur 15 – 25° C. Die Säcke nicht höher stapeln als bei Warenübergabe durch Planatol, damit das Granulat nicht verblockt.

Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen.

Reinigung

Vor dem Einsatz des **Planamelt HSP II** ist auf sorgfältige Reinigung der Anlage zu achten (siehe Beiblatt).

Zur Beachtung

Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz.

Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden.

Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate. Vorschläge von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich.

Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktualisierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien.

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Umstellung von Standard-Rückenleim auf Planamelt HSP II Rückenleim, Reinigung der Auftragsanlage

Durch die sehr gute Reinigungswirkung von Planamelt HSP II kommt es dazu, dass die vercrackten und zersetzten alten Klebstoffreste sowie andere diverse Verunreinigungen aus der Anlage ausgetragen werden. Dank seiner neuen Technologie ist Planamelt HSP II außerdem nicht mit den üblichen EVA Klebstoffen kompatibel, die Klebstoffgemische müssen daher unbedingt vermieden werden, da diese Gemische eine deutlich schlechtere Klebeleistung haben. Daher ist es sehr wichtig, die sorgfältige Vorreinigung der Anlage, die auch mal so aussehen kann (siehe Bild), durchzuführen.

Die Reinigung sollte nur einmal bei der Umstellung von einem EVA Klebstoff auf Planamelt HSP II erfolgen. Während des Nutzens von Planamelt HSP II ist der Reinigungsaufwand viel geringer als bei EVA Klebstoff, die Reinigungsintervalle können deutlich verlängert werden, da Planamelt HSP II oxidationsstabiler ist und selbstreinigende Eigenschaften hat.



Basis-Checkliste (kann je nach Anlage variieren)

1. Den alten Klebstoff im Vorschmelzer (Premelter) lehrfahren und die Reste aus dem Leimbecken ablassen.
2. Die Schläuche vom Leimbecken trennen und das Leimbecken und Vorschmelzer mit Planamelt HSP II füllen (Ablassventile vorher schließen), die Temperatur im Vorschmelzer, Schlauch und Leimbecken auf 170-180°C stellen.
3. Nach dem Aufschmelzen und Erreichen der Temperatur über 130°C die Walzen 10 Minuten drehen lassen.
4. Klebstoff ablassen, separat aus dem Leimbecken über das Ablassventil und aus dem Premelter über die Schläuche. Dabei den Zustand der Anlage und der abgelassenen Schmelze kontrollieren. Die Reste von Ablagerungen im Leimbecken und Vorschmelzer auch mechanisch mit Spatel abspachteln (bitte geeignete Spatel aus Kunststoff oder Holz benutzen, um die Anlage nicht zu beschädigen!)
5. Den Punkt 3 und 4 so lange wiederholen, bis die Maschine ausreichend gereinigt ist und kein Klebstoffgemisch vorhanden ist.

WICHTIG: Durchspülen mit frischen Planamelt HSP II sollte aber mindestens 2 mal stattfinden um eine ausreichende Reinigung zu gewährleisten und den alten Klebstoff komplett aus der Anlage wegzutragen.

6. Filter und Siebe ausbauen und kontrollieren, ggf. reinigen
7. Schläuche an den Leimbecken anschließen und vorgeschlagen Maschineneinstellungen vornehmen, Premelter mit Planamelt HSP II füllen.

Reklamationen, die auf unzureichende Reinigung des Systems zurückzuführen sind, werden nicht akzeptiert.